

集成电路应用指南(一)

主编 由一
王曾
向正

电子工业出版社

集成电路应用指南(一)

由一 王曾 向正 编

电子工业出版社

内 容 简 介

本书是参考国内外集成电路手册,整理汇编而成。全书共分两部分:国内外集成电路生产厂家的产品商标和型号;国产集成电路与国外集成电路互换表。另外还有两个附录,附录 A:国产集成电路厂标型号-部标型号对照表;附录 B:国外集成电路生产厂家的地址、电报和电话号码。

本书是一本较为实用的工具书。它不仅适用于电子工程、计算技术、半导体器件等专业技术人员,也可供家用电器维修人员参考;同时,便于外贸人员和国内集成电路用户与生产厂家取得联系,解决订购、咨询和技术服务等问题。

集成电路应用指南 (一)

由一 王曾 向正 编

责任编辑 轩里九

*

电子工业出版社出版 (北京市万寿路)

北京科技印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 14.625 字数: 327千字

1986年4月第1版 1986年6月第1次印刷

印数: 9000册 定价: 2.90元

统一书号: 15290·288

前 言

为适应我国集成电路应用日益普及的状况,我们编写了这本“集成电路应用指南”。它是参考了美国 Hearst 科技通信出版社编印的“集成电路特性大全”(IC MASTER)、国内近几年出版的集成电路手册和各集成电路生产厂家的产品说明书,整理汇编而成的。

本书共分两部分。

第一部分:国内外集成电路生产厂家的产品商标和型号

第二部分:国产集成电路与国外集成电路互换表

在每部分的正文之前,都给出了使用说明,读者可参照说明,熟悉每部分的使用方法。

为便于更准确地使用本书,在书末给出了两个附录。

附录 A:国产集成电路厂标型号-部标型号对照表。

附录 B:国外集成电路生产厂家的地址、电报和电话号码。

本书作为集成电路的应用指南,是一部具有实用性的工具书,它不仅为电子工程专业技术人员和业余爱好者提供宝贵的参考资料,也为家用电器的维修人员提供了方便,并有利于加强各厂矿企业、学校和科研单位的技术库存。

我们期望本书能为引进国外先进技术,为祖国四化建设作出贡献。

在本书编写过程中,得到有关部门的支持,并得到许多同志的帮助。在此,向这些部门和同志们表示谢意。

编 者

1985年6月

目 录

前 言

第一部分：国内外集成电路生产厂家的产品商标和型号	1
使用说明.....	1
产品商标和型号.....	3
第二部分：国内外集成电路互换表	117
使用说明.....	117
国内外集成电路互换表(数字集成电路).....	119
国内外集成电路互换表(模拟集成电路).....	329
附录 A：国产集成电路厂标型号-部标型号对照表	369
国产数字集成电路厂标型号-部标型号对照表	369
国产模拟集成电路厂标型号-部标型号对照表	408
附录 B：国外集成电路生产厂家的地址、电报和电话号码	411

第一部分 国内外集成电路生产 厂家的产品商标和型号

使用 说 明

国内外集成电路生产厂家都有各自的商标和区别产品的独特的标志方法。当你从集成电路块或外包装上知道商标时,可从本部分查出该集成电路的生产厂家。

通常,集成电路的型号由前缀、基本标号和后缀三个部分组成。当你已知 AM25S05DM 是高级微型器件公司(Advanced Micro Devices)的产品,便可从本部分查出:

AM25S 是前缀,其中,

AM——高级微型器件公司的产品代号;

25——中规模集成电路;

S——肖特基类型。

05是基本标号,表示集成电路的型号序号

DM 是后缀,其中,

D——封装形式为密封双列直插式;

M——温度范围为军用。

再如日立 (Hitachi) 产品 HM472114AP, 可从本部分查出:

HM 是前缀,表示存储功能;

4721114 是基本标号;

AP 为后缀,其中,

A——改进型;

P——塑料封装。

对于国产集成电路来说,其表示方法已由电子工业部的部标做了统一规定。如 T1000、T2000、T3000 和 T4000 系列分别表示 TTL 中速数字电路、高速数字电路、甚高速数字电路和肖特基低功耗电路,而 C000 系列则表示 CMOS 电路等等。但有的厂家采用本厂的厂标。读者可从国内有关的集成电路手册中了解其标志方法,本部分不另行给出,仅向读者提供有关生产厂家的产品商标。

本部分的外国厂家是按英文名称的字母顺序排列的。

产品商标和型号

高级微型器件公司

Advanced Micro Devices Inc.(AMD)



前 缀

AM——AMD 公司产品的代号

功能

- 25——中规模集成电路
- 26——计算机接口电路
- 27——双极存储器电路
- 28——MOS 电路
- 29——双极微处理机
- 90——MOS 电路
- 91——MOS 电路
- 92——MOS 电路
- 94——MOS 电路
- 95——MOS 电路
- 79——通信电路

类型

• 3 •

8710397

L——小功率

S——肖特基

LS——小功率肖特基

空白——标准型

后 缀

封装

D——密封双列直插式

P——模制式

F——扁平式

X——模压式

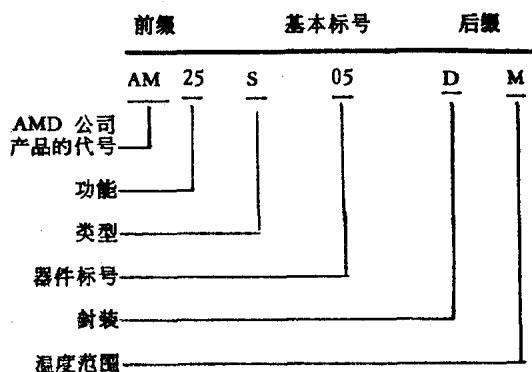
L——无引线芯片托架式

温度范围

C——民用

M——军用

举例说明 AM25S05DM



美国微系统公司

American Microsystem Inc. (AMI)

AMI



A Subsidiary
of Gould Inc

前 綴

种类

S — 标准

后 綴

封装

P — 塑料

D — 陶瓷双列直插式

C — 陶瓷

L — 无引线芯片托架式

引出线/封装

8 — 塑料

14 — 塑料, 陶瓷

16 — 塑料, 陶瓷双列直插式, 陶瓷

18 — 塑料, 陶瓷双列直插式, 陶瓷

22 — 塑料, 陶瓷双列直插式, 陶瓷

24 — 塑料, 陶瓷双列直插式, 陶瓷

28 — 塑料, 陶瓷双列直插式, 陶瓷

40 — 塑料, 陶瓷双列直插式, 陶瓷

64 — 塑料, 陶瓷

20 — 无引线芯片托架式

24 — 无引线对称芯片托架式

24 — 无引线芯片托架式

28 — 无引线对称芯片托架式

28——无引线芯片托架式

40——无引线芯片托架式

44——无引线对称芯片托架式

44——无引线芯片托架式

68——无引线芯片托架式

84——无引线芯片托架式

注：引出线/封装是表示集成电路的引出线数目以及它所能具有的封装形式。

举例说明 S68A00P, S5101L-1C, S2559AP

前缀	基本标号	后缀
S	68A00	P
	5101L-1	C
	2559 A	P
种类		
器件标号		
电参数分类		
封装		

模拟器件公司

Analog Devices Inc. (AD)



前 缀

AD——公司缩写。该公司的产品均标明有 AD 前缀。

• 5 •

后 缀

温度范围

A、B、C、——工业用

J、K、L、——民用

S、T、U、——军用

封装

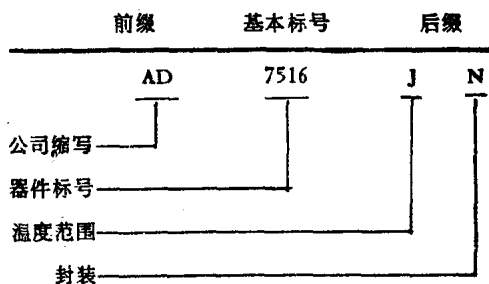
D——陶瓷双列直插式

F——陶瓷扁平式

H——TO-5 型密封(金属圆壳封装)

N——塑料双列直插式

举例说明 AD7516JN



伯尔-布朗研究公司

Burr-Brown Research Corp. (Burr-Brown)

BURR-BROWN



后 缀

温度范围

H, J, K, L—— $0^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

R, S, T—— $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

A, B, C—— $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

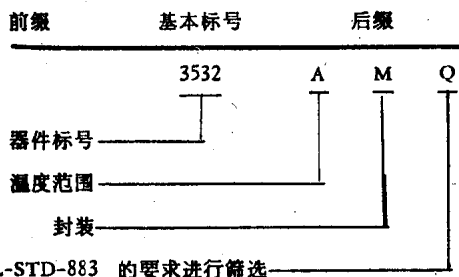
封装

M——金属

P——塑料

Q——按 MIL-STD-883 的要求进行筛选

举例说明 3532 AMQ



福利半导体公司

Cherry Semiconductor Corp. (Cherry)

CHERRY
SEMICONDUCTOR

前 缀

CS——公司缩写(该公司的老产品标明 MMC)

D——二极管倒装片

N——NPN 倒装片

P——PNP 倒装片

后 缀

封装

- 0 —— 未封装器件
- D —— 双列直插式
- P —— “丸式”小圆型封装
- T —— TO 型封装(金属圆壳封装)
- 4 —— 4 引出线
- 8 —— 8 引出线

电路形式

- B —— 国际通用型
- S —— 专用型

举例说明 CS1220DB, CS5558, D823

	前缀	基本标号	后缀
	CS	122	0DB
	CS	555	B
	D	823	
公司缩写/种类			
器件标号			
封装/电路形式			

控制微型系统公司

Cybernetic Micro Systems (Cybernetic)



说明

- CY232——并行/串行接口器件
- CY250——多片控制器
- CY300——液晶驱动器/键盘控制器
- CY360——波形合成器
- CY480——打字机控制器
- CY500——步进马达控制器
- CY512——步进马达控制器
- CY600——数据采集控制器
- CY750——可编程序控制器

戴特-英特西尔公司

Datel-Intersil Inc. (Datel)



前 缀

种类

- ADC——模数转换器
- AM——放大器
- DAC——数模转换器
- DAS——数据采集系统
- FLT——滤波器
- MV、MX——多路调制器
- SHM——取样-保持电路
- VF——电压-频率转换器
- VR——基准电源
- VI——电压转换器

TT——温度传感器

后 缀

封装

若器件为单片型

1——14引出线双列直插式

2——TO-99 型封装(金属圆壳封装)

若器件为混合型

G——环氧树脂密封

M——真空密封

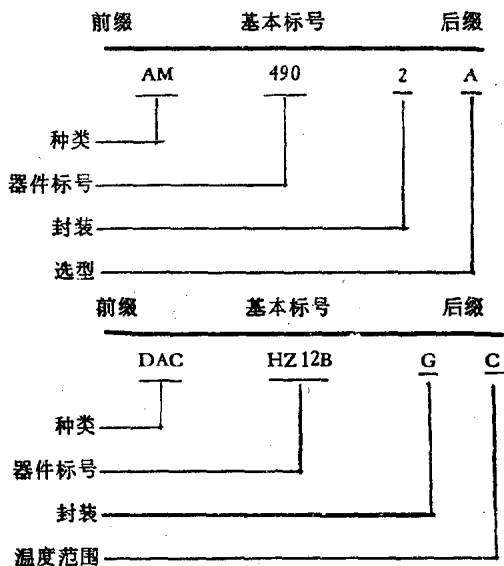
温度范围

C—— $0^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

M—— $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

R—— $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

举例说明 AM4902A DAC HZ12BGC



埃克萨集成系统公司

Exar Integrated Systems Inc. (Exar)



前 缀

XR——公司产品代号

后 缀

等级

C——民用级

M——军用级(陶瓷封装和温度范围为 $-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$)

()——在无C或M时,表示经过严格加工的民用标号

封装

D——片式

P——塑料

N——陶瓷

举例说明 XR567CP

